

Goldman Sachs выпустила отчет, согласно которому китайская индустрия литографического оборудования отстает от США и Европы как минимум на 20 лет.

Литография — ключевой этап производства чипов, именно от нее зависит возможность выпускать современные процессоры на уровне 3 нм и ниже. Сейчас такие технологии есть у голландской ASML, чьи машины используются TSMC, Samsung и Intel.

В Китае ситуация куда сложнее. Из-за санкций, HUAWEI не может заказывать чипы у TSMC, а SMIC ограничена в доступе к современным EUV-сканерам. В итоге китайские производители вынуждены работать с более старыми технологиями и пока способны выпускать максимум 7-нм решения, причем, скорее всего, на базе устаревших DUV-машин ASML.

По данным Goldman Sachs, местные китайские литографические установки находятся на уровне 65 нм. Для сравнения, TSMC уже массово производит 3-нм чипы и готовится перейти на 2 нм.

Аналитики подчеркивают: ASML понадобилось 20 лет и около \$40 млрд инвестиций, чтобы пройти путь от 65 нм до менее чем 3 нм. Поэтому догнать западных лидеров в ближайшие годы китайским компаниям вряд ли удастся.